



软件与服务行业专题：决策篇 (2)：全球车载计算平台赛道核 心玩家全面梳理



车载计算平台是智能网联汽车产业变革的风向标随着汽车智能化程度的逐渐提高，对高性能 SoC 芯片的需求不断提升，主控芯片是所有环节中壁垒最高、商业模式最佳的环节；此外，当前汽车芯片出货量过小，无法充分摊销前期高昂的研发成本。种种因素注定了，SoC 主控芯片一定是长期极其稀缺的赛道，也是只属于少数玩家的游戏，英伟达、高通、英特尔等国际巨头持续发力芯片赛道，国内方面，华为、地平线等正在不断追赶。

高通在中高端智能座舱领域呈现垄断地位

智能座舱作为率先商业化的领域，数字座舱渗透率正在持续攀升，高通作为消费电子龙头目前在智能座舱 SoC 市场遥遥领先，其第二代平台 820A 和第三代平台 8155 获得了大量头部主机厂的定点。高通方案商与生态伙伴对于高通平台 know-how 的理解愈发重要，高通现有的优质合作伙伴优势显著。

自动驾驶刚刚起步，英伟达暂时领先

英伟达凭借其 GPU 的资源禀赋，在硬件上优势显著，英伟达还为主机厂打造了端到端的、开放、高效的研发生态，其生态完善程度和开放程度都是遥遥领先。但是自动驾驶行业刚刚起步，仍然面临诸多不确定性。先进制程的 SoC 芯片面临着诸多短期自动驾驶商业化不确定性的风险。我们更看好有其他芯片主业的龙头厂商能够在自动驾驶 SoC 芯片长期的技术迭代过程中胜出。

汽车智能化浪潮方兴未艾，建议关注相关厂商

汽车智能化浪潮方兴未艾，车载计算平台的技术变革才刚刚开始，不断的产品和技术迭代，为产业链中上游的方案商和软件商提供了大量的增量业务机会，建议关注中科创达、德赛西威、光庭信息、东软集团、四维图新等相关上市公司。

投资摘要

关键结论与投资建议

第一，高通在智能座舱领域遥遥领先。智能座舱作为率先商业化的领域，数字座舱渗透率正在持续攀升，高通作为消费电子龙头目前在智能座舱 SoC 市场遥遥领先，其第二代平台 820A 和第三代平台 8155 获得了大量头部主机厂的定点。

高通方案商与生态伙伴对于高通平台 know-how 的理解愈发重要，高通现有的优质合作伙伴优势显著；

第二，自动驾驶刚刚起步，目前英伟达暂时领先。英伟达凭借其 GPU 的资源禀赋，在硬件上优势显著，此外，英伟达还为主机厂打造了端到端的、开放、高效的研发生态，其生态完善程度和开放程度都是遥遥领先。但是自动驾驶行业刚刚起步，仍然面临诸多不确定性。当前汽车芯片出货量仍然较小，无法充分摊销前期高昂的研发投入，回报周期较长，先进制程的 SoC 芯片面临着诸多短期自动驾驶商业化不确定性的风险。我们

更看好有其他芯片主业的龙头厂商能够在自动驾驶 SoC 芯片长期的技术迭代过程中胜出。

核心假设或逻辑

第一，车载计算平台是整个智能网联汽车的核心，更是汽车智能化产业技术进步的风向标，站在主控芯片厂商的视角，观察整个智能驾驶产业的演变趋势更具有战略价值；

第二，主控芯片从长期看注定是少数玩家参与的赛道，对于技术支持和方案落地等，芯片厂商更倾向于寻找优质方案商来支持其客户的落地；第三，长期合作的方案商对于芯片厂商的生态和平台 know-how 理解更为充分，双方磨合度也更高，反哺双方合作的紧密度。

股价变化的催化因素

第一，自动驾驶产业政策出现重大利好；

第二，图像识别等自动驾驶底层技术出现重大变革；第三，全球主要科技巨头或独角兽发布智能汽车新品。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_37667

